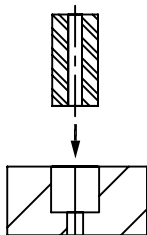
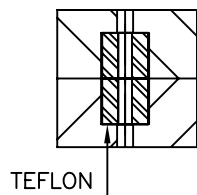


■조립방법 (JIG : DEQ01173-N/1 사용)

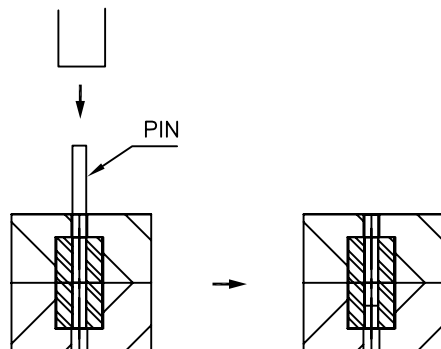
<STEP 1> 절연체 삽입



<STEP 2> JIG 위/아래 체결 (작업성에 따라 볼트 체결 유/무 결정, 접시머리 M2.3 5mm)



<STEP 3> 핀셋 이용하여 핀 삽입 후 가조립 (핀+절연체 가조립 시 지그 손으로 누름)
가조립 완료 후 지그 해체하여 핀 끝까지 누름

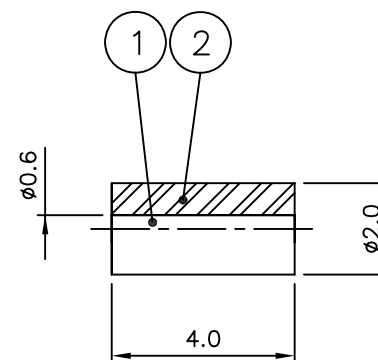


★ 조립 후 검사 주의사항

1. PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단이 절연체 보다 돌출되지 않도록 주의 할 것.
2. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.03.04.



2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/6
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03914-5/6
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2021. 03. 04.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		TITLE BUSHING
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH		SCALE	6/1	DWG NO. CN03890-7/4 REVISION I R SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	